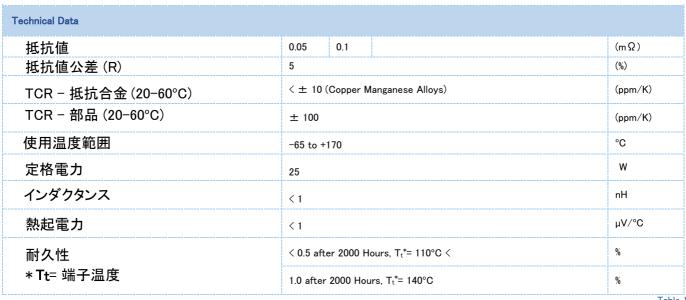


# 特徴

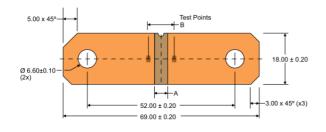
- 銅端子の優れた導電性
- 優れた長期安定性
- 高いピーク電力に対する耐性
- RoHS、REACH認証
- AEC-Q200 認証
- 要求ベースでカスタム対応も可能
- 要求ベースでピン形状のカスタム対応も可能
- 要求ベースで銅端子部のメッキ対応も可能

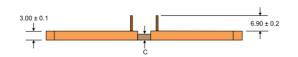
# アプリケーション

- xEVのバッテリー管理システムの電流検出
- バスバーの電流検出
- 溶接機の電流検出

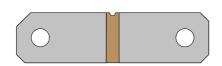








タイプ	A ± 0.5 (mm)	B ± 0.2 (mm)	C ± 0.1 (mm)
SBZ-CM2-R00005	4.5	7.70	2.2
SBZ-CM2-R0001	9.0	12.20	2.2



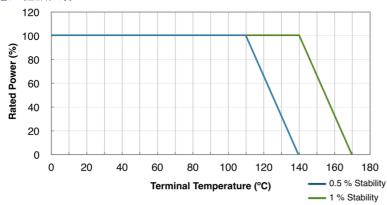
#### \*メッキ対応

- RoHS認証のメッキ
- 標準は錫メッキ:厚さ2.5~8 µ
- 要求ベースで、ニッケル下地0.5~4 µ m可能
- 基本材料:無酸素銅1/2H

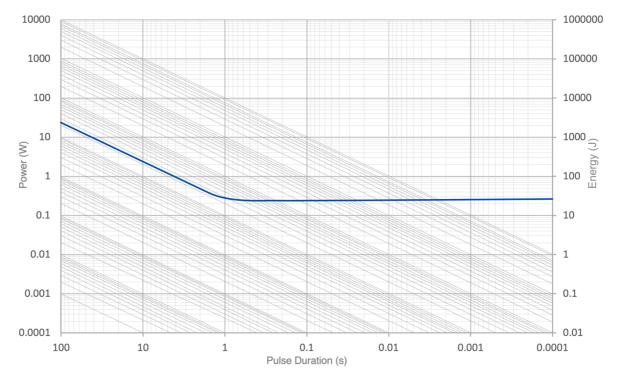




### 電力軽減曲線 R: 0.1mΩ



# 最大パルスエネルギー曲線



Power curve for continuous operation at  $140^{\circ}\text{C}$ 

### 梱包:

- ナイロンバックに100個詰め、標準
- トレイ梱包、要求ベース
- チューブ梱包、要求ベース

# 特性:

試験項目	参照基準	試験条件	合格基準
高温放置	MIL-STD-202 Method 108	170℃環境で1000 時間、通電なし	∆R +/−1%
温度サイクル	JESD22 Method JA-104	-55°C~150°C, 1000サイクル, 各30分	∆R +/−0.5%
高温高湿バイアス	MIL-STD-202 Method 103	85℃ & 湿度85%, 動作電力10%, 1000時間	∆R +/−0.5%
高温寿命	MIL-STD-202 Method 108	定格電力下で125°C, 1000時間	∆R +/−1%
外観	MIL-STD-883 Method 2009	目視検査	目視で異常なし
寸法	JESD22 Method JB-100	図面の寸法に従う	図面の公差内
溶剤耐性	MIL-STD-202 Method 215	水性化学物質で洗浄	レーザー刻印に影響ないこと
振動	MIL-STD-202 Method 213	100gを6ミリ秒間, 正弦半波パルス	∆R +/−0.2%
はんだ耐熱性	MIL-STD-202 Method 204	5gを20分、3方向から12サイクル,10-20	∆R +/−0.2%
はんだ濡れ性	MIL-STD-202 Method 210	はんだ温度260℃, 10秒	∆R +/−0.5%
電気的特性	J-STD-002	J-STD-002 に従う	10倍の倍率で95%以上
短時間過電流負荷	ユーザー仕様	定義された抵抗値	仕様の公差内
低温貯蔵		定格電流の5倍を5秒	∆R +/−0.5%
		−65°C, 24時間	∆R +/−0.2%

Table 2

#### 発注コード例:

### SBZ-6918-CM2-R00005-5-U-NP-BK

(例: 0.05mΩ SBZ 6918 検出ピンなし、メッキなし、袋詰めで出荷)

